

世界トップレベルのシェアと技術力等を強みとし、最先端製品・新製品の開発強化、生産能力の増強などを推進

2023-2025年度 中期経営計画レビュー

2026-2028年度 中期経営計画

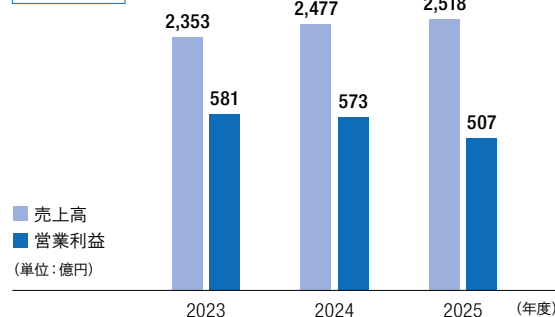
振り返り

- デジタルインターフェース関連は2025年度第4四半期に半導体メモリ不足の影響を受けるも、市場成長に伴い着実に成長。
- 分野全体で中長期的な成長を見据えて積極的に成長投資を実施し、事業基盤を強化。

2025年度売上概要

- 光学フィルム**：液晶テレビ用パネルサイズの大型化に伴う出荷面積の拡大と、広幅対応の新生産ラインが寄与し、前年を上回った。
- 有機ELディスプレイ製造用メタルマスク**：第8世代（G8）サイズのガラス基板向け大型メタルマスクの寄与があったものの、半導体メモリ不足の影響を受け、前年から微減。
- 半導体関連**：市況が堅調に推移したことで前年を上回るとともに、引き続き最先端領域への事業展開に注力。

業績推移



ポートフォリオの変革の考え方

事業拡大の可能性を確認し、ガラスコア基板をはじめとする半導体プロセスの「後工程」に関連する事業を新たに成長ポテンシャル事業として設定した。

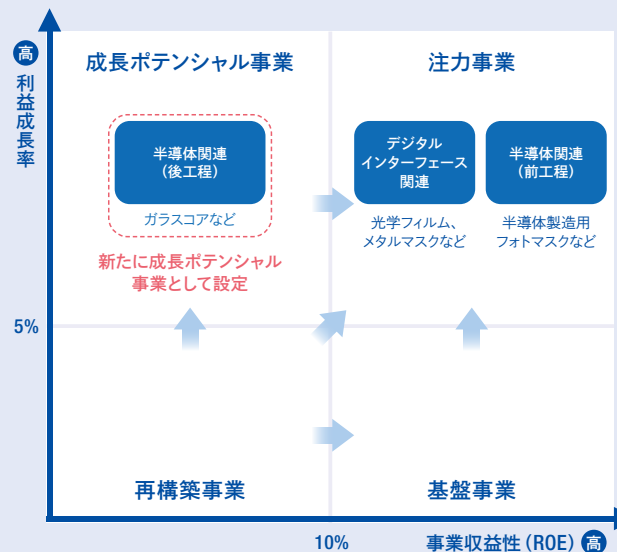
注力事業への積極投資

- デジタルインターフェース関連**：
 - ・**有機ELディスプレイ製造用メタルマスク**：有機ELディスプレイの大型化に伴い、G8サイズの大型メタルマスクを中心に事業を拡大していく。
 - ・**ディスプレイ用光学フィルム**：ディスプレイパネルの大型化に対応した広幅対応の新生産ラインの活用などによって事業を拡大。
- 半導体関連(前工程)**：半導体需要の伸長が続く中、フォトリソの市場成長を先取りした最適な開発・生産体制を構築し、継続的に事業を成長させていく。EUV用マスクや、ナノインプリントなどの最先端領域への事業展開を加速させる。

新たな注力事業の育成

- 半導体関連(後工程)**：次世代半導体パッケージ向けTGV（ガラス貫通電極）ガラスコア基板の技術を中心に、半導体プロセスの後工程を成長ポテンシャル事業と位置づけ、成長を加速させていく。

ポートフォリオの変革



セグメント全体営業利益計画

